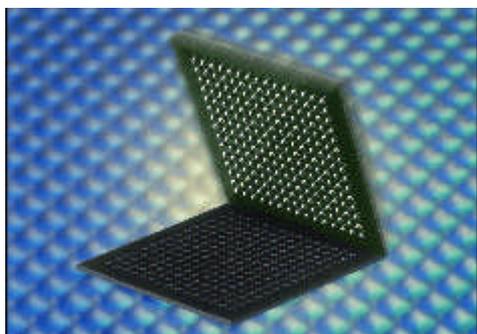


EZReball BGAリボール用プリフォームシート EZReball™

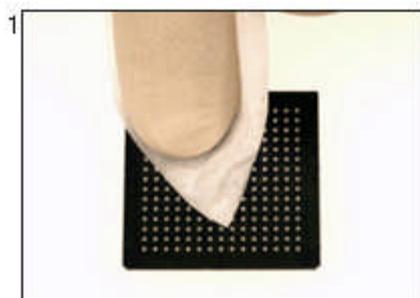
BGAパッケージをプリフォームに載せリフロー炉で加熱するだけ！
BGAのハンダボール再生が素早く簡単に行えます。



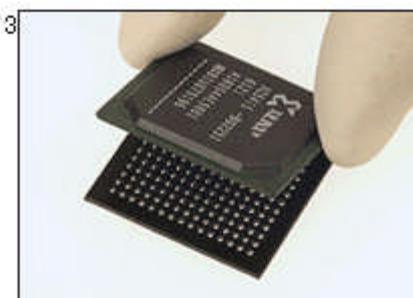
EzReball とは？

BGAパッケージサイズに合わせて加工された高耐熱ポリイミド製のステンシル板にボール配列用の穴を設け、その穴にハンダボールを格納したプリフォーム（ハンダボール格納成型）シートです。

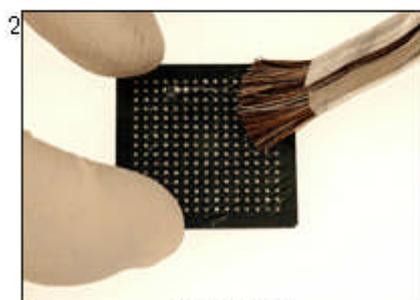
BGAパッケージと同じ形状なので、フラックス塗布後にBGAをプリフォーム上に重ね合わせ、そのままリフロー炉で加熱するだけです。リフロー後は、プリフォームを剥がしIPA等でクリーニングすればリボール完了です。



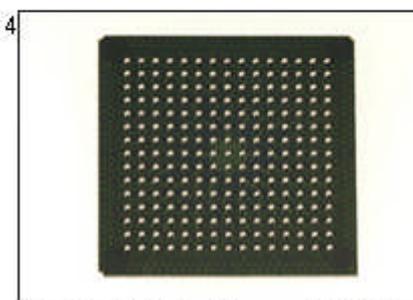
1 残留はんだ除去&クリーニング



3 BGAをプリフォーム上へ載せる



2 フラックス塗布



4 リフロー加熱後、プリフォームを剥がし
クリーニングすればボールハンパ再生
完了

ハンダボール：EZReball™ に使用されているハンダボールはIPC 及び MIL規格で規定されている清浄度、及び寸法公差を満たしております。

標準合金：Sn63Pb37 - 融点 183°C、Sn96.5Ag3Cu0.5 - 融点 217-220°C
その他の合金についてはお問い合わせ下さい。

詳細は、株式会社 シンアペックス 電子機器プロジェクト部門までお問合せ下さい。